

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-013

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第二届董事会第三十六次会议以及第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-027）。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币99,943,551.85元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

2024年3月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币99,943,551.85元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024年3月16日